## 216 半導體元件物理與製程——理論與實務

cess) •

**16.**請以下表比較 Al 與 Cu 製程中 contact、via、及 metal layer 材料之異同,與其原因。

	Al 製程	Cu 製程	附加說明
metal layer 材料			
contact 材料			
via 材料			